

华源证券股份有限公司

关于

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



華源證券股份有限公司

HUAYUAN SECURITIES CO., LTD

青海省西宁市南川工业园区创业路108号

2026年5月

## 目 录

目 录.....	1
一、发行人基本情况 .....	3
二、发行人本次发行情况 .....	24
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 .....	25
四、保荐人与发行人关联关系的说明 .....	27
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 .....	27
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 .....	29
七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 .....	30
八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 .....	30
九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市条件的说明 .....	31
十、持续督导期间的工作安排 .....	35
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 .....	36

**深圳证券交易所：**

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）接受深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“发行人”“鸿富诚”“公司”）的委托，担任鸿富诚首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人概况

公司名称	深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
英文名称	Shenzhen HFC Co., Ltd.
注册资本	5,619.1818 万元
法定代表人	孙爱祥
有限公司成立日期	2003 年 5 月 13 日
股份公司成立日期	2021 年 12 月 2 日
发行人住所及办公地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道 7 号 C 栋一层至三层；腾丰四路 11 号 A 栋、B 栋三层
邮政编码	518103
电话	0755-27327883
传真	0755-27327883-8060
公司网址	www.hfcsz.com
电子信箱	ir@szemi.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
信息披露负责人	杨健虹
联系方式	0755-27327883-8060

### （二）发行人主营业务

公司是一家专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件研发、产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品主要包括导热界面材料、电磁屏蔽及吸波材料。该等材料是保障各类电子信息产品可靠性和稳定运行的关键材料，广泛应用于数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域。

在热管理领域，公司是行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，并直接和国际材料头部企业展开竞争。公司采用创新取向技术，实现石墨烯材料的垂直排列，充分挖掘石墨烯在垂直方向的优异导热性能，通过界面功能化实现极低热阻，目前公司量产产品导热系数达到  $130\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，热阻低于  $0.06^\circ\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$ ，可快速导出热量，同时具备优异的压缩回弹性，能够有效解决高功率大尺寸芯片翘曲形变等关键问题，消除界面空隙，长期使用无泵出风险，保障散热稳定性。在石墨烯导热垫片的基础上，公司于 2024 年进一步成功开发

金属碳基复合材料，产品导热性能好、整体界面热阻低，可用于重复测试，适用于高功率芯片测试等应用场景，有效解决了传统热界面材料“热阻低而难以重复使用，可重复使用却热阻高”的行业痛点。

凭借石墨烯导热垫片、金属碳基复合材料等创新产品，目前公司已进入全球头部 AI 芯片企业导热界面材料供应链并批量供货。公司也是目前国内极少数已经成功实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业。TIM1 热界面材料作为芯片封装内材料，直接接触发热芯片，因此对其导热性能、机械性能以及稳定性要求极为苛刻。公司 TIM1 材料得到客户认可并开始小批量供应，体现了公司在高端导热界面材料的竞争实力和市场地位。同时公司在液冷材料及散热器件上也持续投入研发资源，积极进行相关布局。随着人工智能、超算服务器等高功率芯片应用市场的快速发展，该等领域对热管理要求越来越高，高端导热界面材料已经成为制约产品性能的关键电子材料，公司产品未来市场前景广阔。

在电磁屏蔽材料领域，公司深耕多年，致力于不断改进生产工艺技术，提高产品效能和精密程度，目前已经掌握电磁屏蔽材料生产所需的核心技术，形成了品类完善的产品体系，包括一些工艺难度较高的屏蔽材料，如 SMT 导电泡棉，其兼具耐高温、高回弹和自动焊接等特点，应用于汽车电子行业；半包裹导电泡棉、导电毛丝产品，其具备低应力、高回弹等特点，解决了目前电子产品屏下导电干扰及应用过程中可能出现水波纹问题，产品性能处于国内领先水平，产品应用于各大消费电子品牌终端产品中。

在吸波材料方面，公司基于水基功能涂料制备技术及片状取向工艺技术，可量产具有宽范围导磁性能（在 1MHz 频率下，磁导率值覆盖 50 至 300）的吸波材料，从而达到吸波材料“宽频、环保性”的目标，产品应用于各大消费电子品牌终端产品中。

公司通过多年持续自主研发及产学研合作，围绕“工艺+配方”，积累了众多核心技术，构建了品类齐全、性能领先、应用领域覆盖广泛的产品及技术解决方案体系。截至报告期末，公司共获得 **178 项** 授权专利，其中发明专利 **72 项**，被评为国家级专精特新重点“小巨人”企业、广东省电子器件热传导材料工程技术研究中心、国家高新技术企业、**广东省省级制造业单项冠军（碳基导热垫片）**。公司凭借出色的技术创新能力，荣获国际 R&D100 创新奖等行业奖项，以及华

为技术最佳协同奖、质量优秀协作奖等核心客户奖项。此外，公司还参与制定 4 项国家及行业标准，其中国家标准 1 项，行业标准 3 项。同时，在坚持自主研发的基础上，公司还广泛开展外部产学研合作，包括公司与华中科技大学设立“光电器件高效热管理技术联合实验室”；与深圳先进电子材料国际创新研究院设立“鸿富诚-SIEM 先进电子材料联合实验室”等，共同推动国产高端先进材料的研发及产业化。

### （三）核心技术

公司主要从事热管理材料、电磁屏蔽及吸波材料等先进电子功能材料的研发、生产和销售，属于高分子化学、无机非金属材料、金属材料、碳基材料、电子器件、智能控制等诸多学科交叉融合的综合领域，是典型的技术密集型行业。经过多年的行业经验积累和技术沉淀，公司系统掌握了创新取向技术、粉体处理技术等核心技术，具备生产稳定可靠、性能优异的热管理材料、电磁屏蔽及吸波材料的能力，核心技术来源于自主研发。公司核心技术体系如下：

#### 1、热管理材料

序号	核心技术名称	所处阶段	主要表征特点	技术先进性
1	碳纤维材料取向技术	批量生产	碳纤维材料取向技术是公司研发的一种包含材料配方和碳纤维取向技术在内的热界面材料技术，用于制备具有超高导热系数和超低热阻的复合材料。导热系数最高可达 $50\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，热阻低于 $0.2^\circ\text{Ccm}^2/\text{W}$ 。	鸿富诚通过自主研发的微米级碳纤维定向排列技术，突破了传统填料无序分布的行业瓶颈。该技术通过精密控制工艺参数，使微米级碳纤维粉体在有机硅基体中形成纵向有序排列结构，充分发挥碳纤维轴向导热系数超 $900\text{W/m}\cdot\text{K}$ 的物理特性，构建出高效的导热通道网络。这种创新工艺显著提升产品导热性能的同时，进一步提升了材料的回弹性。目前，鸿富诚碳纤维导热垫片导热系数可达 $50\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，实验室水平已达 $70\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，在 TIM2 和 TIM1.5 场景有着良好应用。凭借该项产品性能优势，打破了前期日本公司（导热系数约达 $35\text{W/m}\cdot\text{K}$ ）在中国碳纤维高端导热垫片市场的垄断。
2	石墨烯材料取向技术	批量生产	石墨烯材料取向技术是公司研发的利用石墨烯膜定向排序技术，以树脂为基体，以石墨烯膜为骨架，采用机械取向方式制备具有取向结构的热界面材料技术。导热系数最高可达 $130\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，热阻低于 $0.06^\circ\text{Ccm}^2/\text{W}$ ，高厚度石墨烯导热垫片压缩 50% 静态	公司石墨烯材料取向技术，由材料与工艺技术配套组成，能充分发挥石墨烯导热性能，实现超高导热超低热阻。利用该技术，量产的填充性导热垫片导热系数可突破 $130\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，超过了部分金属，同时还保留了有机硅橡胶良好的柔软性与回弹性。目前已进入头部芯片企业高端导热材料供应链，实现批量供货，体现了强大的技术实力。

序号	核心技术名称	所处阶段	主要表征特点	技术先进性
			应力可以 $\leq 35\text{psi}$ 。	
3	粉体处理技术	批量生产	公司自主研发的粉体改性技术体系，系通过物理研磨、化学键合及表面包覆等复合工艺对导热填料进行界面功能化处理，以突破高导热绝缘材料性能瓶颈。	公司自主研发的粉体改性技术通过机械研磨分级技术、表面包覆工艺等多维度工艺协同创新，综合运用等离子体表面活化、纳米级异质包覆及多官能偶联剂化学键合等复合改性手段，显著提升高导热填料的分散性、界面相容性及填充效率，成功构建三维连续导热网络，在实现导热系数突破 $20\text{W/m}\cdot\text{K}$ 的同时兼具环保与高效特性。
4	氮化硼取向技术	小批量生产	公司自主研发的氮化硼定向技术聚焦于解决片状氮化硼在有机硅基体中分散性差、取向度低等核心难题，通过“粉体复配-精密机械排序”双路径实现高性能导热材料制备。	公司氮化硼定向技术通过“粉体级配优化-界面改性-应力场诱导取向”全链条创新，突破行业导热瓶颈：一是首创多模态粒径复配技术，通过亚微米级与微米级氮化硼协同填充，结合硅烷偶联剂界面改性，将填充率提升至 70% 以上；二是开发高精度机械定向工艺，采用定向-温度-压力协同控制模型，实现片层取向度 $> 85\%$ ，垂直方向导热系数突破 $15\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，较传统无序填充产品提升超 3 倍以上，介电常数 $\leq 5$ ，兼具高绝缘、低密度等综合优势，可以满足 5G 高频器件等场景对低介电损耗与高可靠性的严苛需求。
5	液态金属界面处理技术	批量生产	公司自主创新研发的一种金属碳基复合材料，其采用多层复合技术制备，将低熔点金属与高导热材料相结合，实现了界面间隙的高效填充，显著降低了热阻，同时中间层的高导热材料提供了稳定的热传导路径，导热率可达 $80\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上，整体界面热阻可达 $0.05^\circ\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$ 以下。适用于高功率芯片测试等应用场景。	液态金属界面处理技术主要包含以下突出技术特点： 1、高导热系数 本技术形成的新型产品金属碳基复合材料导热系数 $80\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上，大幅提升材料导热能力； 2、超低界面热阻、厚度多样 产品厚度 $0.05\text{-}0.5\text{mm}$ ，热阻最低达 $0.05^\circ\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$ 以下，显著提升高功率芯片散热速度； 3、便捷可靠 常温下为固态，安装便捷，无需围堵，节省设计空间；不流动、无垂直孔洞，返修方便，长期工作不腐蚀金属及芯片。
6	粉体复配技术	批量生产	粉体配方是决定导热界面材料性能的关键性因素，配方形成需要大量的测试、分析和经验。公司经过多年的研发投入和技术积累，构建了品类齐全、性能领先以及工艺适配性良好的多元化配方体系。	目前，公司已经形成近 500 种导热界面材料配方，全面覆盖公司导热硅胶垫片、碳基导热垫片、导热凝胶等各类核心产品线。依托公司粉体复配技术，同时结合公司创新取向工艺等生产的导热硅胶垫片导热系数达 $20\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，导热凝胶导热系数达 $14\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，碳纤维导热垫片导热系数达 $50\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，处于行业领先水平。

## 2、屏蔽材料

序号	核心技术名称	所处阶段	主要表征特点	技术先进性
1	功能材料包裹技术	批量生产	自主研发适用于石墨导热泡棉、低压缩应力导电泡棉、SMT 导电泡棉、全方位导电泡棉等多元产品的先进成型包裹技术,通过精准控制包裹张力、优化接缝口结构、创新多层复合包裹工艺,实现了包裹精度控制、界面附着力提升等技术突破,可适配电子设备散热、精密仪器导电、高频通信屏蔽等多领域复杂应用场景需求。	<p>1、采用石墨导热层与导电布和泡棉缓冲层复合结构,石墨层通过高热路径实现热量快速传导,泡棉层利用高弹性形变特性高效吸收冲击能量,使产品兼具高效屏蔽、散热与优异缓冲减震性能;</p> <p>2、创新采用接缝无搭接包裹设计,搭配高性能丙烯酸压敏胶材料,常温下自带稳定粘性无需加热活化,既减薄产品不可压缩层厚度以降低整体压缩应力,又省去加热工序,显著减少能源消耗;</p> <p>3、基于核心技术自主研发专属材料配方与制备工艺,创新推出定制化注射成型技术,突破传统工艺局限,使产品具备可靠的镀锡兼容性与自动焊接适配性,满足自动化生产场景的高效装配需求。</p>
2	精密模切加工技术	批量生产	公司深耕核心加工领域,掌握异步切片、异步模切、精密切割等多项先进工艺技术。其中,异步加工技术通过独立轴联动控制与动态张力调节系统,实现多工序同步高效运转,生产效率较传统工艺大幅提升;精密切割技术搭载激光定位与闭环反馈控制模块,切割精度远超行业常规标准。同时,产品结构采用模块化创新设计,兼具轻量化与高稳定性优势,配合全流程精细化管控体系,确保产品加工一致性、性能稳定可靠,可有效满足高端电子、精密机械等领域的严苛应用需求。	<p>1、优化加工工艺路径与排版方案,通过智能套料算法,制定匹配的送料规划,大幅降低材料损耗,有效节约生产成本;</p> <p>2、采用标准化接口设计与自动化适配模块,实现连续化、自动化装贴作业,作业效率较传统人工模式提升,保障生产流程高效顺畅推进;</p> <p>3、搭载高精度伺服驱动系统与视觉定位补偿技术,加工精度可达可控,支持多尺寸、多材质(金属、非金属、复合材料等)组合同步模切,兼容从微型精密件到大型复杂件的多样化加工需求,适配性与场景覆盖能力行业领先。</p>
3	自动检测包装技术	批量生产	公司自主研发全自动多尺寸检测系统与产品自动检测包装一体化技术。搭载高速视觉成像,实现多维度尺寸在线实时检测、不良数据智能分析与检测结果即时反馈;集成检测、分选、补装,包装全流程自动化作业,可自动完成不良品剔除、合格品定位包装,检测与包装效率较传统人	<p>1、集成多尺寸在线实时检测、不良品自动剔补、数据统计与智能分析功能,搭载视觉识别算法与动态检测模型,检测速度快、尺寸检测精度高;同步生成可视化数据看板,直观呈现检测合格率、不良类型分布等核心指标,为工艺优化提供实时数据支撑;</p> <p>2、采用高精度伺服抓取系统与视觉检测模块,可精准抓取产品并对正反面及表面外观进行全方位检</p>

序号	核心技术名称	所处阶段	主要表征特点	技术先进性
			工模式大幅提升；支持检测参数柔性化设置，适配多规格产品快速切换，同时生成可追溯的检测数据报告，为生产工艺优化提供精准数据支撑，助力品质闭环管理。	测，通过智能判定算法自动剔除不良品，将合格品精准植入载带穴位，生产效率较传统人工检测模式大幅提升，良率稳定在99.8%以上。

### 3、吸波材料

序号	核心技术名称	所处阶段	主要表征特点	技术先进性
1	水基功能涂料制备技术	批量生产	采用水作溶剂的水基涂料，避免有机溶剂的大量使用，降低VOC排放，最大限度保护员工健康。	水性功能涂料是将无机功能粉体与水性乳液混合，在一系列水系助剂的配合下，制备出的高效、安全、环保、多功能的水性功能涂料。功能涂料浆料制备过程需要克服水性涂料制备过程中面临的问题，同时兼顾功能粉体的特性。公司研发了一套制备水基功能涂料的技术，包括定制化水性胶体技术（使得粉体填充比例达到80%以上）、分散方式及润湿剂搭配技术（高效解决粉体分散问题）以及设备升级改造能力。现已将该技术应用于吸波材料的生产，同时推广在水性氮化硼浆料、铁氧体浆料制备中。
2	片状取向技术	批量生产	利用磁性颗粒粉体易受磁场影响特性，对磁粒子进行取向诱导，同时，通过控制浆料中粉体浮力与重力平衡，达到优秀取向效果。	吸波材是一种将片状软磁FeSiAl粉末（直径50-150um，厚度1-2um）与高分子材料混合而成的薄片状产品。产品的吸波能效与片状粉体的取向程度有关，即片状粉体在面内方向层层堆叠能获得最佳吸波效果。片状粉体在水性浆料中的方向是随机的，而且由于表面电荷排斥作用，无法获得良好取向效果。公司经过长期研发和攻关，在对磁场类型、强度、方向等细致调整优化，发明了一种使用简单的软磁取向条，利用磁场对粉体进行诱导，同时，通过控制浆料中粉体的浮力与重力平衡，让粉体取向得到突破，性能达到粉体最佳水平。
3	粉体复配技术	批量生产	粉体配方是决定吸波材料性能的核心要素之一。公司历经多年持续的研发投入与技术攻关，已成功构建品类齐全、性能卓越、绿色环保的多元化配方体系，并形成了与之配套的先进制备工艺，为产品竞争力奠定了坚实的技术基础。	目前，公司已经形成了近130种吸波材料配方，全面覆盖公司各类吸波材料产品线。依托自主研发的粉体复配技术，结合均匀分散技术和可控取向工艺，公司实现了水溶性吸波材料在1MHz下磁导率达300的关键突破。橡胶微波吸波材料则具备2-100GHz频段全覆盖。该工艺在显著降低生产成本的同时，契合绿色环保制造要求，体现出显著的经济与社会效益。

公司核心技术是公司通过持续积累并自主创新而形成的技术成果，在主营业务及产品或服务中得到广泛应用，核心技术助力公司销售收入持续增长。报告期

内，公司的核心技术产品收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	67,477.15	30,338.14	23,730.16
主营业务收入	70,424.90	32,789.84	25,852.83
占主营业务收入比重	95.81%	92.52%	91.79%

#### （四）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施

公司充分认识到知识产权在企业经营中的重要作用与核心价值，持续保护核心技术。针对核心技术对应的工艺优化、技术迭代以及产品创新等，公司积极申请相关知识产权。截至报告期末，公司各项核心技术对应取得专利情况如下：

##### 1、热管理材料

序号	核心技术名称	相关专利
1	碳纤维材料取向技术	201710697597.3 各向异性绝缘导热垫及其制造方法 202011006331.8 一种导热纤维在胶体内自动定向排序设备及方法 202011049523.7 一种使导热丝定向排序的导热垫片制备工艺及导热垫片 202110127399.X 一种碳纤维丝油压排序装置及排序工艺 202110127367.X 一种化学处理式碳纤维排序工艺及碳纤维切断装置 202110129939.8 一种针织式纤维排序工艺以及辅助治具 202110212635.8 一种碳纤维导热导电材料的成型工艺及排序装置 202110247286.3 一种短纤维喷射取向的成型工艺 202111361619.1 一种三维导热吸波增强复合膜及其制备方法 202210794425.9 一种各向异性导热相变材料及其制备方法 202310492860.0 碳纤维导热垫片的制备方法 201721019395.5 各向异性绝缘导热垫 201920755371.9 一种碳纤维定向挤出成型设备 202220553869.9 一种用于提高碳纤维取向的挤出嘴模具 202221291547.8 一种用于导热材料取向的液压挤出装置 202222682038.4 取向模具 202222682040.1 多层堆叠式易拆模具 <b>202211257344.1 一种导热界面材料及其制备方法和应用</b> <b>202211245791.5 高取向性导热界面材料的制备工艺及使用的取向模具</b> <b>202211668610.X 一种高回弹低热阻界面材料及其制备方法</b>
2	石墨烯材料取向技术	202111067331.3 一种石墨烯导热垫片及其制备方法 202111067334.7 一种石墨烯导热垫片包边工艺及包边石墨烯导热垫片 202111367075.X 一种导热吸波复合膜的制备方法和导热吸波复

序号	核心技术名称	相关专利
		合膜 202210590852.5 一种芯片封装结构及封装方法 US17/580635 Graphene thermally conductive gasket edge-wrapped process and edge-wrapped graphene thermally conductive gasket (一种石墨烯导热垫片包边工艺及包边石墨烯导热垫片) 202122217553.0 一种包边石墨烯导热垫片 202122213698.3 一种石墨烯导热垫片 202122827863.4 一种导热绝缘石墨烯垫片 202122941451.3 一种石墨烯导热垫片 202122926288.3 一种自粘型石墨烯导热垫片 202221317195.9 一种具有屏蔽壳封装的导热垫片 <b>202422923896.2 一种散热系统</b> <b>202422937819.2 一种散热系统</b> <b>202520271109.2 一种包覆型石墨烯导热垫片及电子设备</b> <b>202520284190.8 一种导热垫片</b> <b>202520274610.4 一种石墨烯复合导热垫片及电子设备</b> <b>202510188232.2 一种复合导热垫片及其制备方法</b>
3	粉体处理技术	202111418644.9 一种低回弹、不掉粉硅胶导热垫片及其制备方法 202211313569.4 一种树脂组合物及应用其制备的半固化片、覆铜板 202011547886.3 一种高导热绝缘垫片及其制备方法 202011597656.8 导热绝缘填料、导热绝缘材料及其制备方法 202221888161.5 一种导热硅凝脂自动灌装装置
4	氮化硼取向技术	202010993396.X 一种导热绝缘碳纤维硅胶垫片及制备方法 202111367134.3 一种取向型导热凝胶、制备方法及其应用
5	液态金属界面处理技术	202310928038.4 一种液态金属导热材料及其涂层与制备方法和应用 202311276962.5 一种散热器件的制备方法 202322579737.0 一种喷涂装置 <b>202411262866.X 一种热响应型液态金属导热垫片及其制备方法</b> <b>202411905165.3 一种精准控温液态金属散热垫片高效制备方法</b>
6	粉体复配技术	201210586609.2 一种高导热柔性硅胶垫片及其制备方法 201310372003.3 一种高导热绝缘导热硅胶垫片及其制备方法 201310378005.3 一种高导热石墨散热片的制备方法 201310465860.8 一种储能散热片及其制备方法 202010938611.6 一种高强度超低介电性的发泡导热硅胶垫片及其制备方法 202010993715.7 一种导热吸波复合材料及制备方法 202010993386.6 一种导热吸波硅胶复合材料及制备方法 202111361641.6 一种高导热吸波复合材料及其制备方法及吸波导热垫片 202122827865.3 一种三维导热吸波增强复合膜 202122827862.X 一种导热吸波复合膜 <b>202310559750.1 一种高弹导热硅胶材料、高弹导热硅胶垫片及制备方法</b> <b>202411905172.3 一种多层复合式导热材料制备方法</b>

## 2、屏蔽材料

序号	核心技术名称	相关专利
1	功能材料包裹技术	TR202108075Y GRAFİT KÖPÜK（一种石墨泡棉） TR202108272Y İLETKEN KÖPÜK（一种导电泡棉的加工工艺及导电泡棉） 202220743430.2 一种自动贴泡棉挡条的挡板装置及压延机 202021164087.3 一种石墨泡棉 201920093065.3 半包裹导电垫片 202010584990.3 一种切片式贴片制作工艺与制成的贴片 202010772631.0 一种导电泡棉的加工工艺及导电泡棉 202210062642.9 导电泡棉注射成型装置及导电泡棉注射成型工艺 202323481153.6 一种施胶装置以及施胶系统 201620133111.4 一种导电毛丝 201821664650.6 导电垫片 202322983218.0 一种挤出头和挤出装置 202120477240.6 一种散热性好的拼接式导电泡棉 201510248816.0 一种电磁屏蔽用导电泡绵及其制备方法 202323310361.X 一种导电泡棉生产线 201310199021.6 一种导电泡棉及其制作方法 201821925857.4 一种泡棉背胶牵引结构 200810111242.2 导电泡棉转贴装置 201610098325.7 一种导电泡棉及其制造方法 202010577376.4 一种单面贴片的无痕加工工艺及单面贴面的异位加工设备 202121702321.8 一种镀金铜箔 C 型、M 型包裹导电泡棉 202123362676.X 一种导电泡棉及制造导电泡棉的治具 202220165798.5 一种导电泡棉
2	精密模切加工技术	202010576391.7 一种单面贴片的无痕加工工艺及单面贴面的异位加工设备 202122444658.X 一种持续分条切断设备 202121697590.X 一种多工位圆刀机包裹导电泡棉装置 202111178738.3 一种持续分条切断设备及应用该设备的切断工艺 202323486403.5 一种导电垫片用切片机 202110832073.7 一种单轴异步张力器 202121682004.4 一种单轴异步张力器 202323667416.2 模切去废料装置及模切产线 201821935172.8 一种用于泡棉切条装置的去静电结构 201821925788.7 一种导电泡棉自动成型分切设备 201821929206.2 一种用于泡棉切条装置的输送结构 202120275053.X 一种防卡刀的模切装置 201821929207.7 一种泡棉切条装置 202110839878.4 一种多工位圆刀机包裹导电泡棉装置 <b>202422206455.0 一种治具以及导电泡棉生产线</b>
3	自动检测包装技术	202210298619.X 一种自动产品检测、移除及补位机器 202121701064.6 一种异步裁切机的监测装置

### 3、吸波材料

序号	核心技术名称	相关专利
1	水基功能涂料制备技术	201821929210.9 一种吸波材料的成型设备 202323239766.9 一种复合吸波片以及电子器件 202010577372.6 一种导热吸波卷带的制备工艺及其成品 202010993715.7 一种导热吸波复合材料及制备方法 202010993386.6 一种导热吸波硅胶复合材料及制备方法 202111367075.X 一种导热吸波复合膜的制备方法和导热吸波复合膜
2	片状取向技术	201410145486.8 一种吸波材料及其制备方法
3	粉体复配技术	202111361641.6 一种高导热吸波复合材料及其制备方法及吸波导热垫片 202111361619.1 一种三维导热吸波增强复合膜及其制备方法 202210319938.4 一种锰锌铁氧体软磁合金吸波材料及其制备工艺 202210319951.X 一种 Mn-Zn 铁氧体-FeSiAl 复合吸波材料及其制备方法 202122827865.3 一种三维导热吸波增强复合膜

公司已制定完善的内部控制制度，强化技术保护，已制定《知识管理办法管控制程序》等制度对成果、技术及相关资料进行管理。此外，公司持续对员工进行培训，与核心技术人员签订了保密协议以及竞业禁止协议。

公司对主要经营场所均设定涉密区域并实施专门管制，对相关人员出入权限进行设置并对信息安全防护管控，有效保护与隔离涉密信息。同时，公司注重信息安全建设，对 OA、ERP 等核心系统均设置严格准入权限。

#### （五）公司科研实力和成果情况

##### 1、参与的国家及行业标准制定情况

截至报告期末，公司参与的国家及行业标准制定情况如下：

序号	标准名称	标准编号	发布部门	实施时间
1	《金属镀膜织物金属层结合力的测定胶带法》	GB/T40262-2021	国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会	2021/12/1
2	《铁硅铝基复合吸波材料》	YS/T1485-2021	工信部	2022/4/1
3	《铜镍复合导电泡棉》	YS/T1486-2021	工信部	2022/4/1
4	《镍锌铁氧体复合箔材》	YS/T1417-2021	工信部	2021/7/1

##### 2、取得的技术认证或荣誉情况

截至报告期末，公司已累计获得科研相关奖项情况如下表所示：

序号	获奖主体	年度	荣誉	授予单位
1	鸿富诚	2024 年度	国家级专精特新重点“小巨人”企业	工信部
2	鸿富诚	2023 年度	科技创新奖	深圳市半导体产业发展促进会
3	Shenzhen HFC Co., Ltd. (注)	2023 年度	国际 R&D100 创新奖	R&D World
4	鸿富诚	2022 年度	国家级专精特新“小巨人”企业	工信部
5	鸿富诚	2025 年度	高新技术企业	深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局
6	鸿富诚	2021 年度	广东省电子器件热传导材料工程技术研究中心	广东省科学技术厅
7	鸿富诚	2021 年度	深圳市“专精特新”中小企业	深圳市工业和信息化局

注：该奖项为发行人与纳米及先进材料研发院有限公司共同获得。

#### (六) 发行人主要经营和财务数据及财务指标

报告期内，公司主要经营和财务数据及财务指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额（万元）	85,442.22	54,062.11	43,335.42
归属于母公司所有者权益（万元）	70,042.43	42,384.89	35,052.13
资产负债率（母公司）	14.94%	17.58%	15.54%
营业收入（万元）	70,666.16	32,968.62	26,038.45
净利润（万元）	27,031.82	7,150.51	3,476.17
归属于母公司所有者的净利润（万元）	26,908.33	7,146.79	3,496.81
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	26,419.92	7,008.14	3,240.73
基本每股收益（元/股）	4.81	1.28	0.63
稀释每股收益（元/股）	4.81	1.28	0.63
加权平均净资产收益率	48.13%	18.46%	10.51%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,398.79	7,853.18	3,290.14
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	4.59%	7.92%	9.55%

## （七）发行人存在的主要风险

### 1、与发行人相关的风险

#### （1）技术风险

##### ①技术研发风险

公司产品主要包括热管理材料、电磁屏蔽及吸波材料，广泛应用于数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域。公司主要产品的技术研发需要系统性地掌握材料配方和工艺技术等多个维度的关键技术，以及能够基于各应用场景定制解决方案的能力，涵盖化学、物理、机械工程与自动化等多个专业学科领域，要求材料厂商具备深刻的技术沉淀和产业化经验积累。

热管理材料方面，发行人确立了“以取向技术为驱动、多相复合为手段、界面优化为落脚点”的总体技术路线，开发更高导热性能的材料体系（由高分子硅基向金属基、碳基方向发展）、研发更优的高导热填料技术（高导热填料、定向排序）以及界面热阻控制技术，驱动热管理材料向更高性能、更稳定方向发展，满足 AI 高功率芯片、数据中心、高功率 IGBT 等前沿领域对极致散热的需求；屏蔽材料方面，发行人主要围绕提升屏蔽效能、适应多场景及复杂环境、实现多功能集成等方向展开研发；吸波材料方面，主要向轻量化、高效宽频、环境适应性强、可定制化、绿色环保等方向展开研发。目前发行人在垂直取向石墨烯导热垫片、金属碳基复合材料等产品建立了较强的技术研发领先优势。

随着下游应用领域产品及技术的加速迭代，若公司未来在技术发展方向上未能做出准确判断，相关核心技术升级迭代放缓或无法持续创新，导致新产品的性能未能满足下游客户的应用需求，则公司将面临技术研发未达预期的风险，进而对公司核心竞争力与经营业绩造成不利影响。

##### ②技术人才流失与核心技术泄密的风险

新材料行业作为技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，需要公司通过长期持续的研发投入和技术创新构建自研独立的核心技术与知识产权体系；同时，稳定的核心技术团队以及高端人才的战略储备是支撑公司技术研发与核心竞争力的重要基础之一。自成立以来，公司通过自主研发形成并掌握了一系列技术成果，建立了完善的技术保密制度与管理体系，搭建了稳定的核心技术团队。

未来，随着行业竞争的加剧，高端技术人才的争夺将更为激烈。若公司无法为技术人才提供具有竞争力的薪酬待遇、激励机制和发展平台，或在经营中因管理不善、工作失误及外部窃取等因素，导致公司面临核心技术人员的流失以及核心技术泄密，将对公司的技术研发能力、业务发展及经营业绩产生不利影响。

### ③研发投入未取得预期效果的风险

鉴于 AI 算力、数据中心、智能汽车、消费电子等下游应用领域产品技术的快速迭代特点，公司需要持续在新的产品技术上投入大量的资金以巩固和提升市场竞争力。报告期内，公司各期研发投入金额分别为 2,487.50 万元、2,611.22 万元和 **3,244.02** 万元，占营业收入比例分别为 9.55%、7.92%和 **4.59%**。如果公司产品技术研发进度严重滞后于行业发展速度，或在产品技术研发过程中未能实现关键技术的突破，甚至研发失败导致公司研发成果无法实现产业化，则公司将面临研发未达预期且前期研发投入无法收回的风险，对公司的产品销售和财务状况造成不利影响。

### ④核心技术被追赶或超越的风险

公司在石墨烯导热垫片、金属碳基复合材料等高端热管理材料细分领域处于行业领先地位，相关产品已实现规模化量产并进入全球头部客户的供应链体系。但热管理材料行业技术迭代速度快，且下游 AI 芯片、智能汽车等领域的散热需求持续升级，行业呈现技术路线多元化发展趋势。国内同行业公司正加大对高端热管理材料的研发投入，加速推进相关产品的产业化进程，国际头部企业也在布局新型热管理材料产品，若竞争对手在短期内突破核心技术瓶颈，实现同类产品的规模化量产并通过头部客户验证，可能会对公司的市场份额和产品售价形成冲击。同时，若其他技术路线在性能、成本、量产性上实现重大突破，更好地满足下游高功率场景的散热需求，将对公司石墨烯、金属碳基等核心技术路线的产品形成替代。此外，若公司核心技术人才流失导致技术扩散，使竞争对手快速掌握相关研发和量产技术，缩短与公司的技术差距，或公司未能持续加大研发投入、紧跟行业技术发展趋势，将面临技术领先性丧失的风险，进而对公司的核心竞争力和经营业绩造成不利影响。

## **(2) 经营风险**

### **①产品价格下降的风险**

公司石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料等高端热界面材料, 凭借先进的产品性能, 在目前高端热管理材料市场由美国、日韩、欧洲等境外同行业公司占据主导的竞争格局下, 成功通过下游头部企业客户验证并进入其供应链体系, 实现量产供应。未来若随着市场竞争加剧、同类竞品产生, 而公司在产品性能、高端和境外市场拓展、客户开发等方面未能持续保持竞争力, 则存在陷入市场价格竞争的可能, 届时或将面临产品价格下降的风险, 从而对公司的盈利能力产生不利影响。

### **②原材料供应风险**

报告期内, 公司采购的主要原材料包括石墨烯原材料、导热粉体、液态金属材料、导电布类、胶类、泡棉类等, 其中, 石墨烯原材料、液态金属材料系根据公司要求定制, 因此存在向单一国内供应商采购的情况。虽然该等供应商不存在进出口等贸易争端风险且公司已与其建立了稳定的合作关系, 但若未来该等供应商生产经营发生不利变化, 或因合作理念、原材料供应不稳定等因素与公司业务合作关系发生变化, 将会影响公司高端产品原材料供应的稳定性, 则公司正常生产经营可能会受到不利影响。

### **③产品质量风险**

公司主要产品广泛应用于数据中心 (AI 高功率芯片、光模块)、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域, 客户对公司产品的质量及可靠性要求较高, 生产端具有制备过程复杂、工艺控制难度高等特性。随着下游行业及客户对产品性能要求不断提升, 若公司产品出现大量质量缺陷, 或上游供应商提供的产品或者服务出现质量及可靠性问题, 导致公司交付产品未能满足客户对品质的要求, 则公司需要对此承担相应的赔偿责任, 将对公司的经营业绩、客户合作关系与市场声誉等方面产生不利影响。

### **④客户集中度风险**

报告期内, 公司向前五大客户的销售收入占比分别为 43.63%、48.23%和 66.70%, 呈逐年上升趋势。公司存在向前几大客户集中的趋势, 主要原因系公司

向该等客户供应石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料等高端导热界面材料产品并持续放量。若公司该等客户受到国际或地区贸易环境的影响或由于行业景气度下降、同类竞品的出现，导致其向公司下达的订单数量或价格下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。同时，若公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，或出现重大客户流失风险，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。此外，随着供应链运行逐步成熟稳定，部分核心终端客户的采购模式由其直接下单逐步转为通过代工厂直接采购，可能导致公司前五大客户构成发生变动。

#### ⑤业绩增速放缓或业绩下滑风险

受益于下游行业特别是 AI 算力基础设施爆发式增长，2025 年公司营业收入和扣非后归属于母公司净利润分别为 70,666.16 万元和 26,419.92 万元，较 2024 年度大幅增长 114.34%和 276.99%，其中热管理材料及器件的销售收入为 56,883.62 万元，较 2024 年度 19,978.50 万元大幅增长，带动 2025 年净利润大幅增长。尤其是金属碳基复合材料得到头部客户认可从小批量测试迅速进入大规模量产，销售额达 19,175.18 万元，而上年度销售额仅 41.06 万元。虽然热管理产品下游 AI 数据中心、智能汽车等领域总体上仍处于高速增长阶段，公司也在积极拓展新的应用场景、开拓新的优质客户，目前公司在手订单也较为充足。但公司认为 2025 年度业绩超常规增长有一定特殊性。2026 年 1-3 月，发行人未经审计的营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 16,994.33 万元和 6,225.06 万元，较上年同期增长 74.15%和 162.30%，较 2025 年度增速有所放缓。受以下因素的影响，未来公司存在业绩增速放缓甚至业绩下滑的风险：

(1) 下游行业未来因市场供需变动、宏观经济等因素的影响出现资本开支增速放缓，导致公司产品市场需求减弱、订单下降；(2) 客户基于供应链稳定性考虑，积极开发备选供应商，以及同行业企业实现技术突破，都可能导致新竞争者加入从而加剧市场竞争程度；(3) 公司研发不足或者行业技术迭代引发下游客户对主流技术路线选择发生变化，导致公司现有主要产品及解决方案难以满足下游客户需求；(4) 为支撑长期战略发展、突破关键技术瓶颈及巩固技术领先优势，公司在推动现有产品技术迭代、优化工艺技术和产品性能的同时，更需要面向未

来5-10年的新材料前沿技术超前布局,因此未来几年公司势必加大研发投入;(5)目前HBM存储芯片短缺且未来1-2年仍供应紧张,制约AI芯片产品出货量增长或放缓其出货节奏,进而影响发行人产品销售。

#### ⑥订单取消、变更及订单减少的风险

2023年至2025年,发行人存在部分调整/变更/取消订单的情形,主要系客户需求调整、客户内部交易主体变更、订单数量或交期变化等因素所致。2023年至2025年,调整/变更/取消订单金额占当期新签订单总额的比例分别为3.72%、2.62%和6.43%。其中,2025年占比有所上升,主要系受特定终端客户项目临时调整将订单转移至其内部通用项目、不同代工厂商或内部厂区之间产能调配或内部生产任务变更等因素影响。尽管终端需求未实质性减少,且公司通过统一调配保障整体交付,但未来公司在手订单及新签订单仍受宏观经济环境、市场需求变化、行业竞争格局调整、下游客户产品需求变化及合作双方履约安排调整等多重因素影响,公司存在订单取消、订单变更、后续订单数量减少的风险。

#### ⑦关税政策变动风险

报告期内,公司部分下游客户为美国企业,公司直接出口美国且贸易模式为DDP的产品销售收入分别为920.66万元、1,250.97万元和**1,158.54**万元,占营业收入的比例分别为3.54%、3.79%和**1.64%**。2025年10月,中美举行经贸磋商,自2025年11月10日起,美国取消针对中国商品加征的10%的关税,对中国商品加征的24%的“对等关税”将继续暂停一年,根据敏感性测算,关税上升10%,对利润总额的影响比例分别为-2.33%、-1.53%、**-0.37%**。由于美国关税政策变化频繁,公司难以预测未来关税政策变化及关税水平,若主要出口市场长期维持或加征高关税等贸易限制政策,可能导致公司成本增加、境外销售增速放缓,甚至出现下降的风险,进而影响公司经营业绩。

### (3) 财务风险

#### ①毛利率下降的风险

报告期各期,公司综合毛利率分别为46.41%、52.32%和**65.56%**。毛利率水平较高,主要是受技术优势、行业特点、市场竞争、客户性质、产品结构等多方面因素的影响。经过多年的持续研发和投入,公司形成了以石墨烯导热垫片、金

属碳基复合材料等高端导热界面材料为核心的电子功能材料体系，能够有效解决高功率芯片翘曲等行业痛点，具备较强的技术优势，且目前公司是行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，并供应行业头部客户，竞争优势明显。

期后毛利率方面，2026年1-3月发行人未经审计综合毛利率为**67.76%**，与2025年度综合毛利率**65.56%**总体保持稳定。未来随着能够量产石墨烯导热垫片厂商陆续增加或其他竞品的出现，市场竞争将会加剧。若未来市场下游需求变化、竞争对手实现石墨烯导热垫片等核心产品研发量产突破、开发出其他技术路线的新产品、新竞争者加入等导致竞争进一步加剧或者公司的经营策略、技术实力、成本控制等因素发生不利变化，以及受客户议价等因素影响，则公司产品销售价格可能出现下降，或原材料价格上涨，而无法向下游顺利传导，无法抵御成本上升的不利影响，导致毛利率无法维持较高水平，甚至存在显著下降的风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。

### ②应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,219.46万元、12,785.46万元和**30,424.38**万元，占当期营业收入的比例分别为39.25%、38.78%和**43.05%**，总体保持快速增长。未来随着公司经营规模持续扩大，如果公司不能相应提高应收账款管理水平，或客户因市场竞争加剧或行业景气度下降等因素导致资信状况恶化，可能使得公司面临应收账款无法收回的风险。

### ③汇率波动风险

报告期内，公司境外主营业务收入金额分别为11,083.49万元、14,052.57万元和**46,491.24**万元，占主营业务收入的比例分别为42.87%、42.86%和**66.02%**。报告期内，公司汇兑损益分别为-78.96万元、-240.15万元和**698.96**万元，占各期利润总额的比例分别为2.00%、2.93%和**-2.21%**。剔除汇率影响后报告期扣非归母净利润分别为3,161.77万元、6,767.99万元和**27,118.88**万元，汇率对归母净利润的影响占剔除汇率影响后扣非归母净利润的比例分别为2.50%、3.55%和**-2.58%**。

报告期内，公司外销比例逐步上升，出口主要结算货币为美元。近年来，受

全球经济形势、国际地缘政治冲突等因素影响，人民币与美元之间的汇率波动性较大，如未来美元出口主要结算货币产生较大波动，将可能导致公司以人民币计算的销售价格波动，以及导致公司持有的外币资产和负债产生较大汇兑损益，导致公司盈利水平产生波动。若公司不能及时采取有效的措施，则公司面临汇率波动风险，进而影响经营业绩。

假设公司其他因素保持不变，外币对人民币汇率变动-3%、-1%、1%、3%时，对公司利润总额的敏感性测试如下表所示：

单位：万元

报告期	项目	外币兑人民币汇率波动幅度			
		-3%	-1%	1%	3%
2025 年度	营业收入变动	-1,394.74	-464.91	464.91	1,394.74
	财务费用变动	919.68	306.56	-306.56	-919.68
	汇率变动影响小计	-2,314.42	-771.47	771.47	2,314.42
	利润总额	31,615.60	31,615.60	31,615.60	31,615.60
	汇率变动影响占比	-7.32%	-2.44%	2.44%	7.32%
2024 年度	营业收入变动	-421.58	-140.53	140.53	421.58
	财务费用变动	315.13	105.04	-105.04	-315.13
	汇率变动影响小计	-736.71	-245.57	245.57	736.71
	利润总额	8,192.94	8,192.94	8,192.94	8,192.94
	汇率变动影响占比	-8.99%	-3.00%	3.00%	8.99%
2023 年度	营业收入变动	-332.50	-110.83	110.83	332.50
	财务费用变动	246.04	82.01	-82.01	-246.04
	汇率变动影响小计	-578.55	-192.85	192.85	578.55
	利润总额	3,952.84	3,952.84	3,952.84	3,952.84
	汇率变动影响占比	-14.64%	-4.88%	4.88%	14.64%

注 1：正数表示上涨，负数表示下降；

注 2：营业收入变动金额=以外币结算的销售收入×外币兑人民币汇率变动率；

注 3：境外采购极少，汇率波动对营业成本变动影响忽略不计；

注 4：财务费用变动金额=（期末外币负债-期末外币资产）×外币兑人民币汇率变动率；

注 5：汇率变动影响小计=营业收入变动-财务费用变动。

公司外币结算销售收入占比较高，外币兑人民币汇率波动对经营业绩影响显著。外币兑人民币汇率上升时，对公司利润产生正向影响。经测算，2023 年度、2024 年度及 2025 年度，汇率每上涨 1%，各报告期利润总额分别上升 4.88%、3.00%、2.44%；当外币汇率兑人民币汇率下降 1%时，各期公司利润总额分别将

下降 4.88%、3.00%、**2.44%**。

#### **(4) 法律风险**

##### **①主要经营场所系租赁取得且存在产权瑕疵的风险**

目前公司主要经营场所系租赁取得。若公司所租赁的物业到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违约等情况，公司将面临搬迁带来的潜在风险，并可能对公司的业务经营造成不利影响。如果发生租金大幅上涨的情形，可能会对公司整体的经营业绩造成不利影响。

公司租赁的位于深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路 A 幢厂房、宿舍及空地，深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路 11 号 B 幢三层，以及深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区 0A-04 区 C 栋房屋所在土地为集体建设用地，规划用途为工业，因历史遗留原因，至今尚未办理有关房屋产权登记手续。虽然根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局于 2025 年 9 月 15 日出具的《关于协调出具深圳市鸿富诚新材料股份有限公司及其关联公司租用场地可持续性经营证明的复函》，截至目前，该用地范围不涉及宝安区已列计划城市更新单元，不涉及深圳市 2025 年度土地整备计划内项目。但是上述房产未来能否顺利续租，客观上仍然存在一定的不确定性以及可能导致搬迁的风险，可能会给公司经营带来一定程度的不利影响。

发行人的实际控制人已出具因租赁房屋相关事项导致发行人无法继续使用上述房屋或者因此受到损失时，对发行人由此造成的全部损失承担赔偿责任的承诺。因此，该情形不会对发行人持续经营产生重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性障碍。

##### **②实际控制人不当控制的风险**

公司实际控制人为孙爱祥及赵建平。本次发行前，孙爱祥持有公司 32.03% 股份，赵建平持有公司 25.97% 股份，合计持有公司 58.00% 股份。同时，孙爱祥为鸿富诚管理、鸿富诚咨询和鸿领管理的执行事务合伙人，控制鸿富诚 9.86% 表决权。孙爱祥与赵建平合计控制鸿富诚 67.86% 的表决权。报告期内，孙爱祥长期担任鸿富诚的董事长和总经理，赵建平担任公司董事。孙爱祥、赵建平可以利用其对公司的控制地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实

施重大影响并控制公司业务，如果控制不当将可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

## **(5) 募集资金运用的风险**

### **① 募集资金项目投资风险**

公司本次募集资金主要用于先进电子功能材料基地建设项目、深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目、营销服务网络及总部基地建设项目、补充流动资金以及发展与科技储备资金。本次募投项目全部建成达产后公司固定资产和无形资产将大幅增加，达产年（T5 年）每年新增折旧摊销 4,201.73 万元。如果募集资金不能及时或足额到位，或项目组织管理、场地购建、生产设备安装调试、量产达标等不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投产时间、投资回报及公司的预期收益，进而影响公司的经营业绩。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧和无形资产产生的摊销，则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司未来的经营业绩。

### **② 募投项目新增产能的消化风险**

本次募投项目“先进电子功能材料基地建设项目”的实施，将新增较大规模的公司产品产能，其中石墨烯导热垫片新增产能 36,000 平方米、金属基导热材料新增产能 10,000 平方米。该等产品主要面向数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车、通信、消费电子等领域，下游行业需求及新客户新场景开拓对公司产能消化具有重要影响；同时，同行业竞争对手持续投入研发以寻求在石墨烯及液态金属领域进行技术突破并形成量产产能。虽然公司在决策过程中进行了认真的可行性研究分析，并制定了审慎的产能建设达产安排以及募投产能消化措施，但若宏观经济形势、市场环境、市场竞争、技术迭代、贸易争端等情况发生不利变化，将会对募投项目新增产能消化产生不利影响。

### **③ 募投项目场地尚未取得的风险**

截至目前，发行人已就募投项目主要实施场地与深圳市海岸新城投资有限公司签署《海创大厦定制买卖合同》，约定发行人购置位于深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）03-05 地块工程规划许可证所包含的海创大厦 1 栋厂房第 01、02、03、04 层物业，用途为厂房，该房屋预测建筑面

积合计为 10,220.40 平方米；同时亦与深圳市海岸新城投资有限公司签署相关租赁协议。尽管发行人已与募投项目主要实施场地产权人签署买卖合同和租赁协议，但若发行人未能如期取得募投项目场地，将会推迟募投项目的实施，从而导致募投项目不能及时产生效益，对发行人经营效率和盈利情况造成不利影响。

## 2、与行业相关的风险

### (1) 宏观经济及行业周期波动风险

公司产品主要面向数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域，该等行业受到宏观经济及半导体行业周期的影响。如果宏观经济在未来受不确定性因素影响而发生较大波动，或出现了周期性的全球宏观经济恶化，导致对公司产品需求下降，将会对公司经营业绩产生较大影响。

### (2) 贸易争端风险

**公司热管理核心产品广泛应用于数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车等领域。**近年来，随着贸易争端加剧，部分国家和地区采用包括但不限于提高关税、限制进出口、列入“实体清单”等多种方式或者制裁措施实行贸易保护主义，**尤其是在人工智能（AI）芯片领域，贸易管制政策呈现常态化、精细化、全球化升级趋势，对全球 AI 芯片产业链及上游配套电子功能材料行业造成深远影响。**贸易争端可能导致发行人出口成本因加征关税大幅上升，产品市场竞争力下降，订单流失、出口规模缩减；可能引发技术壁垒、检验检疫标准提高、进口限制等非关税贸易壁垒，导致发行人产品无法进入主要出口区域市场，市场准入受阻；贸易争端发展具有较强不确定性，将使发行人经营决策面临较大挑战，经营管理成本增加，同时可能影响投资者信心及客户合作意愿，对发行人长期发展产生不利影响。报告期内，公司对美国、我国台湾地区客户销售金额较大。若未来贸易争端持续恶化，可能会对公司境外市场销售产生不利影响，从而对公司经营业绩造成不利影响。

### (3) 市场竞争加剧的风险

随着下游应用领域的市场增长，**尤其是随着人工智能产业的发展，电子功能材料行业进入快速发展阶段。发行人依托石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料等核心产品，成功跻身全球头部 AI 芯片企业热管理材料供应链，并实现批量供货。**

报告期内，来自境外客户收入占比持续提升，尤其是 2025 年金属碳基复合材料的量产，使得外销主营收入占比达到 66.02%。由于该等产品量产时间相对较短，供应链地位尚需进一步稳固，同时产品附加值相对较高，吸引国际国内众多竞争者入局，相关核心产品面临市场竞争加剧的风险。

目前国际材料巨头企业在高分子基、金属基等热界面材料领域仍然占领高端市场主要份额，并针对 AI 芯片等高端热管理材料持续进行开展研发或并购，包括但不限于碳基方向的持续研发。公司虽然在垂直取向石墨烯导热垫片方面具备先发优势，但与国内外材料行业巨头相比，在业务体量、资金实力、品牌影响力等方面尚存在一定差距。未来随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，公司将面临市场竞争加剧的风险，如未来公司无法持续加强技术和竞争优势，则存在市场份额和利润水平下降的风险，对公司持续发展将产生不利影响。

### 3、其他风险

根据证券市场相关法规的要求，如果本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足，则公司应当中止发行。若公司中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，则将发生发行失败的风险。

## 二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,873.0606 万股 (不含行使超额配售选择权的数量)	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,873.0606 万股 (不含行使超额配售选择权的数量)	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 7,492.2424 万股 (不含行使超额配售选择权的数量)		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
预测净利润 (如有)	不适用		

发行方式	包括但不限于采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会、深圳证券交易所许可的其他方式
发行对象	符合资格的战略投资者（如有）、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】元
募集资金净额	【】元
募集资金投资项目	先进电子功能材料基地建设项目
	深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目
	营销服务网络及总部基地建设项目
	补充流动资金
	发展与科技储备资金
发行费用概算	本次新股发行费用总额为【】万元，其中： 承销费及保荐费【】万元 审计费【】万元 律师费【】万元 用于本次发行的信息披露费【】万元 发行手续费【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	【】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
<b>（二）本次发行上市的重要日期</b>	
刊登发行公告日期	【】
开始询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	【】

### 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

#### （一）本次证券发行的保荐代表人

本保荐人指定赖昌源、任东升作为鸿富诚首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。

赖昌源先生：保荐代表人，金融学硕士，华源证券投行业务二部总经理。从事投资银行工作以来参与和主持的项目包括：北鼎股份（300824）、联赢激光（688518）等 IPO 项目；深天地（000023）要约收购、深华发（000020）收购项目、天桥起重（002523）重大资产重组、东方智造（002175）上市公司收购等并购项目；生益科技（600183）非公开发行股票、保力新（300116）向特定对象发行股票、大为股份（002213）2022 年非公开发行股票、国安达（300902）向特定对象发行股票、沅江城投公司债等项目。赖昌源先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

任东升先生：保荐代表人，工学硕士，华源证券投行业务一部总经理。从事投资银行工作以来参与和主持的项目包括：士兰微（600460）IPO、天利高新（600339）IPO、天宏纸业（600419）IPO、天富热电（600509）IPO、迪康药业（600466）IPO、泸州老窖（000568）配股、方大炭素（600516）IPO、金路集团（000510）股权分置改革、利尔化学（002258）IPO、川润股份（002272）IPO、天齐锂业（002466）IPO、天际股份（002759）IPO、天沃科技（002564）非公开发行股票、雪峰科技（603227）非公开发行股票、朱老六（831726）精选层挂牌、远翔新材（301300）IPO 等。任东升先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

## （二）本次证券发行项目协办人

本项目协办人为任麓。

任麓女士：会计学学士。从事投资银行工作以来参与的项目包括：利源精制（002501）收购、保力新（300116）向特定对象发行股票、大为股份（002213）2022 年非公开发行股票等项目。

## （三）本次证券发行项目组其他成员

其他项目组成员包括：郭达辉、王洋洋、林川钦、汪志俊成、宋德华、高波。

## （四）联系方式

联系地址：湖北省武汉市江汉区青年路中海中心 30 层

联系电话：027-51663158

## 四、保荐人与发行人关联关系的说明

截至本上市保荐书签署日，保荐人和发行人不存在关联关系。

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其重要股东、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其重要股东、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人主要股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）除上述情形外，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

## 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

### （一）保荐人关于本项目的内部审核程序

本保荐人在向中国证监会和深交所推荐本项目前，通过项目立项审批、质量控制部门预审及内核小组审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

#### 1、项目立项审批

根据《华源证券股份有限公司权益类投资银行业务立项管理办法》，华源证券设立投资银行业务立项审核委员会（以下简称“立项审核委员会”），履行立项审议决策职责。保荐项目由项目组提出立项申请，经所属部门负责人同意，投行质控团队初步审核通过后，报立项审核委员会审核。鸿富诚首次公开发行股票并上市辅导项目及鸿富诚首次公开发行股票并在创业板上市保荐承销项目的立项申请分别于2022年11月24日和2025年9月29日得到本保荐人立项审核委员会的审批同意。

#### 2、质量控制部门预审

根据《华源证券股份有限公司权益类投资银行项目管理办法》，投行质控团

队履行对权益类投资银行项目质量把关和事中风险管理等职责。

鸿富诚本次首次公开发行股票并在创业板上市项目由项目组按照《华源证券股份有限公司权益类投资银行业务质量控制现场核查办法》的规定准备完毕并经部门负责人同意后，于 2025 年 10 月 9 日向投行质控团队、内核部提出现场核查申请。投行质控团队、内核部接到项目组提出的现场核查申请后组建现场检查小组，对项目组提交的申请文件进行初步审查，了解尽职调查工作进展情况，针对尽调问题与项目组进行持续沟通。现场检查小组于 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 17 日到鸿富诚开展现场核查工作，访谈发行人主要管理人员并实地走访生产车间、办公场所，指导项目组对申请文件进行修改和补充披露，审核项目工作底稿的完备性，并于 2025 年 10 月 23 日出具《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司创业板 IPO 保荐与承销项目之现场核查及预审意见报告》（以下简称“《预审意见报告》”）及底稿验收意见。根据项目组对《预审意见报告》相关问题回复及补充核查情况、申请文件及工作底稿完善情况，投行质控团队于 2025 年 11 月 11 日出具《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司创业板 IPO 保荐与承销（含辅导）项目之质量控制报告》《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司创业板 IPO 保荐与承销（含辅导）项目之内核阶段工作底稿验收报告》，并就项目的尽职调查工作情况履行了问核程序。预审完成后，内核秘书准备内核小组资料，联系内核小组委员，并将项目组修改完善后的申请文件及内核通知送达内核小组委员。

### 3、内核会议审核

根据《华源证券股份有限公司投资银行类业务内核工作管理办法》，股权类业务内核小组（以下简称“内核小组”）负责股权类证券发行承销与保荐的内部核查与风险控制。本项目内核小组会议于 2025 年 11 月 14 日在华源证券中海中心会议室召开，参加本次内核会议的内核委员共 7 人。与会内核小组委员听取了项目负责人、保荐代表人、项目组对本项目的汇报并对本次发行申请文件的完整性、合规性进行了审核，项目组对内核小组委员提出的问题进行了回复。内核会议形成审核意见，经内核秘书整理后交由项目组进行答复、落实及修订申请文件。反馈意见被落实及申请文件修订完毕后，由投行质控团队和内核部复核，并将相关回复及文件送达与会内核小组成员。经参会内核小组委员投票表决，内核会议审核通过本项目并同意向中国证监会及深交所推荐。

## （二）保荐人关于本项目的内核意见

通过履行以上内部核查程序，本保荐人认为鸿富诚本次首次公开发行股票并在创业板上市申请符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及中国证监会、深交所规定的发行条件。本保荐人内核小组同意将鸿富诚首次公开发行股票并上市申请文件上报深圳证券交易所审核。

## 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐鸿富诚本次首次公开发行股票并上市，并据此出具本上市保荐书。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，华源证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九) 中国证监会规定的其他事项。

华源证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。

## **七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明**

2025年10月28日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2025年11月13日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

2025年12月8日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2025年12月9日，发行人召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的议案》等与本次发行上市相关的议案。

经核查，保荐人认为：发行人首次公开发行股票并上市方案已经取得发行人董事会、股东会批准，发行人董事会、股东会就本次发行上市有关议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。发行人股东会授权董事会及其授权人士办理有关本次发行上市事宜的授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

## **八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程**

本保荐人对发行人管理层进行了访谈，了解发行人主要产品及行业的相关产业政策，查阅发行人的审计报告、财务明细账、产品销售合同等资料，通过公开

渠道查阅相关政策性文件，查阅发行人参与制定的国家标准、行业标准及团体标准，查阅发行人拥有的专利、软件著作权，核查发行人在研发创新方面取得的荣誉、奖项。

发行人不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》列明的不支持申报创业板行业，发行人具备成长性和良好的创新能力，具有创新以及与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的特征，属于成长型创新创业企业，符合创业板定位。

发行人不属于禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业，发行人不存在主要依赖国家限制产业开展业务的情形，发行人的生产经营符合国家产业政策。

## **九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市条件的说明**

本次证券发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

### **（一）符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件**

按照《注册管理办法》“第二章发行条件”的相关规定，本保荐人对发行人本次证券发行的发行条件进行逐项核查，说明如下：

#### **1、发行人符合《注册管理办法》第十条的规定**

（1）保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司于2003年5月注册成立，并以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

经核查，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，符合《注册管理办法》第十条的规定。

（2）保荐人查阅了发行人历次股东（大）会、董事会、监事会、董事会专门委员会的会议文件，股东（大）会、董事会和监事会议事规则以及相关制度文件。

经核查，保荐人认为：发行人依法建立健全了股东（大）会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书制度，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

## 2、发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定

保荐人查阅了发行人有关财务基础资料和立信会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第 Z110455 号），核查了发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料等资料。经核查，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

保荐人查阅了发行人各项内部控制制度，核查了发行人报告期内重大违法违规情况，并查阅了立信会计师出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 Z110456 号）。经核查，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

## 3、发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定

### （1）符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定

保荐人查阅了发行人主要财产的权属凭证、相关合同等资料，对发行人运营情况进行尽职调查。经核查，发行人具备与经营有关的业务体系，合法拥有与主营业务相关的设备、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，发行人资产完整。

保荐人查阅了发行人股东（大）会、董事会、监事会会议资料，查看了发行人聘任高级管理人员的相关协议，抽查了签署的《劳动合同》，取得了发行人及其董事、监事（取消前）、高级管理人员的书面确认，以及对有关人员进行了访谈。经核查，截至本上市保荐书出具日，发行人高级管理人员未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东及其控制的其他企业领取薪酬；财务人员均系公司专职工作人员，未在主要股东及其控制的其

他企业中兼职，发行人人员独立。

保荐人查阅了发行人及其子公司的财务管理制度，对发行人财务部门等有关人员进行了访谈和征询，复核了立信会计师出具的《内部控制审计报告》（**信会师报字[2026]第 ZI10456 号**）。经核查，发行人具有独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，未与第一大股东及其控制的其他企业共用银行账户，发行人财务独立。

保荐人查阅了发行人的公司章程、三会议事规则等制度文件，了解发行人的公司治理结构、组织机构和职能部门的设置情况，访谈了发行人相关高级管理人员。经核查，发行人的机构设置独立于第一大股东及其控制的其他关联企业，未发生与第一大股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，发行人机构独立。

保荐人取得了发行人第一大股东出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅了发行人与关联企业签订的相关合同。经核查，发行人业务独立，与第一大股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与第一大股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

## （2）符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定

保荐人核查了发行人重大采购合同、重大销售合同、主要供应商、主要客户等资料，了解发行人主营业务开展情况；查阅了报告期内发行人历次股东（大）会、董事会、监事会及董事会专门委员会会议资料，取得了最近 2 年内发行人核心技术人员名单、简历、劳动合同等资料，对发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况及原因进行了核查。

经核查，保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；第一大股东和受第一大股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年控制权没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符

合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（3）符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定

保荐人查阅了发行人的经营资料、重大资产权属文件、财务报告和审计报告、企业信用报告等资料，核查发行人涉及诉讼仲裁等情况，并与发行人律师进行了沟通核实，分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

**4、发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定**

经核查发行人工商档案资料、报告期内的销售合同、以及发行人信用报告等资料，核查了主营业务实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策。保荐人认为：发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

经核查发行人第一大股东、实际控制人提供的个人简历及其出具的相关承诺、无犯罪记录，并公开检索相关资料，本保荐人认为：发行人及其第一大股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

经核查发行人董事、监事会取消前任职监事和高级管理人员提供的个人简历及其分别出具的相关承诺、公安机关无犯罪记录，并公开检索相关资料，本保荐人认为：发行人的董事、监事会取消前任职监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

## （二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

发行人本次发行前股本总额为 5,619.1818 万元，公司本次拟公开发行股票不超过 1,873.0606 万股，发行人股本总额不低于 3,000 万元，符合《上市规则》2.1.1 第二款的规定。

## （三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

公司本次发行前股本总额为 5,619.1818 万元，公司本次拟公开发行股票不超过 1,873.0606 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%，符合《上市规则》2.1.1 第三款的规定。

## （四）财务指标符合《上市规则》规定的标准

2024 年和 2025 年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 7,008.14 万元和 26,419.92 万元。最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，满足《上市规则》2.1.2 第一款的规定。

经逐项核查，本保荐人认为，发行人符合《上市规则》规定的公开发行股票并在创业板上市的条件。

## 十、持续督导期间的工作安排

主要事项	具体计划
（一）持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	（1）督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； （2）督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见

主要事项	具体计划
4、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。	督导发行人遵守《公司章程》、相关法律法规关于对外担保的规定
5、督促发行人建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	督导发行人进一步完善已有的信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度，督导发行人严格依照相关制度实施。与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
6、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； (2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； (3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务
7、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料； (2) 列席发行人的股东会、董事会； (3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件； (2) 接受保荐人尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
(四) 其他安排	无

## 十一、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；华源证券同意作为鸿富诚本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华源证券股份有限公司关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人(签名): 任麓  
任麓

保荐代表人签名: 赖昌源      任东升  
赖昌源                      任东升

内核负责人签名: 晏珍珍  
晏珍珍

保荐业务负责人签名: 王小练  
王小练

保荐机构法定代表人签名: 邓晖  
邓晖

